

ケミトロニクス事業説明会

2026/8/24

ケミトロニクス事業本部

ケミトロニクス事業について

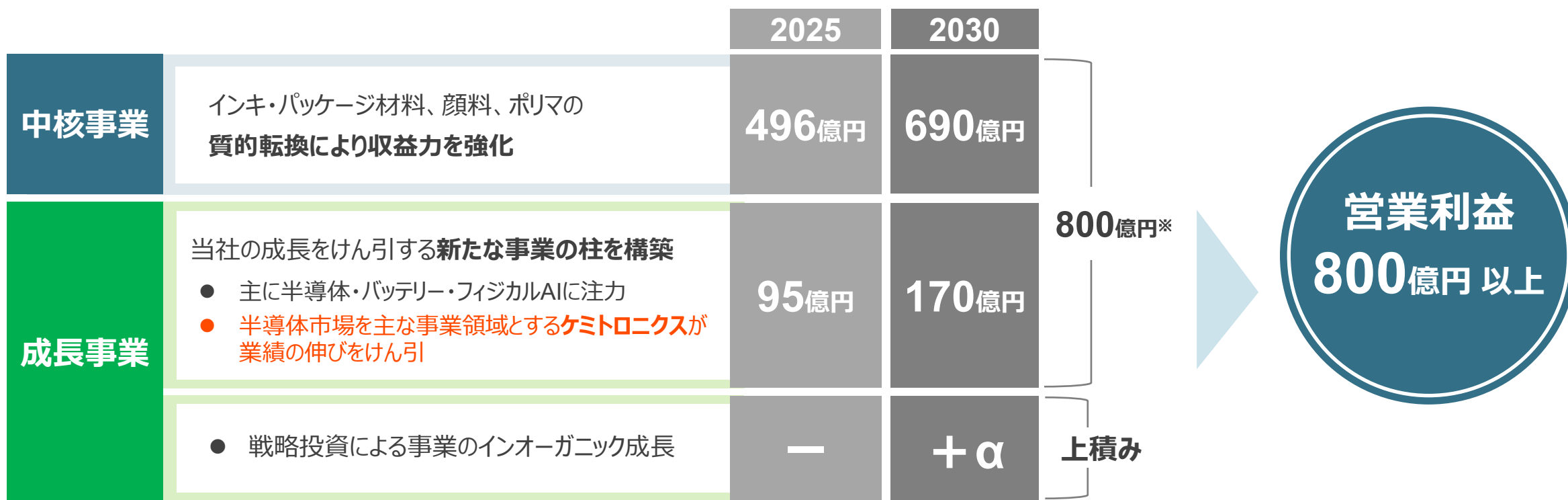
● 長期経営計画「DIC Vision 2030」Phase 2 におけるケミトロニクス事業	03
● ケミトロニクス事業の概要	06
● 前工程材料	19
● 後工程材料	24
● まとめ	28

長期経営計画「DIC Vision 2030」 Phase 2 におけるケミトロニクス事業

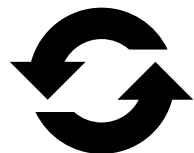
目指すポートフォリオ像とケミトロニクス事業の位置づけ

DIC CHEMITRONICS

- 収益の柱である3つの中核事業の質的転換とともに、当社が成長を見込む領域を成長事業として育成し、営業利益800億円以上を創出する
- ケミトロニクス事業は、半導体・電子材料等の高成長・高付加価値領域への事業ポートフォリオ転換をけん引する成長ドライバー



※合計(800億円)には共通費用等を含むため、中核事業と成長事業の合算金額とは異なる



- 中核事業の収益力強化や成長事業の基盤整備のための投資を実施
- 同時に不採算・ノンコア事業からの撤退を進め、経営資源を成長分野に再配置

- ・パッケージング & グラフィック
- ・カラー & ディスプレイ
- ・ファンクショナルプロダクツ ★はケミトロニクス

	2019～2021年「DIC111」	2022～2025年「DIC Vision 2030」Phase1	2026～2030年「DIC Vision 2030」Phase2
戦略投資	2021:BASF Colors & Effects 買収 (顔料) 2020:Sensient 買収 (ジェットインキ) 2020:遼寧天麒 買収 (グラビアインキ) 2020:Seller ink 買収 (スペリヤリティインキ) 2019:Ideal Chemi Plast 買収 (コーティング用樹脂)	2025:マレイミド樹脂生産能力増強★ 2023:PCAS Canada 買収★ (フォトレジスト用ポリマー) (現Innovation DIC Chemitronics Inc. 以降、IDC) 2022:広東TOD 買収 (コーティング用樹脂) 2022:Sapici 買収 (接着剤)	2029:半導体用エポキシ樹脂新プラント★ 2027:活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤 生産能力増強★ 2026:フォトレジスト用ポリマー生産能力増強★
事業撤退	2021:江南化成JV解消 (汎用樹脂) 2019:愛敬化学JV解消 (汎用樹脂) 2019:DICコベストロポリマーの出資比率変更 50%→20% (汎用樹脂) 2019:国内のSMCおよび成形加工事業売却	2025:泡消火薬剤事業撤退 2024:液晶材料事業撤退 2024:DICデコール売却 (内装建材用塗料・住宅材料、建築内装材) 2023:星光PMC売却 2023:PTBP事業撤退	2027:太陽HD売却 (予定)

※ケミトロニクス関連を中心に現時点で開示可能なものを記載

ケミトロニクス事業の概要



**ケミ트로ニクス事業本部長
原 穂 （はら みのる）**

2001 年 入社

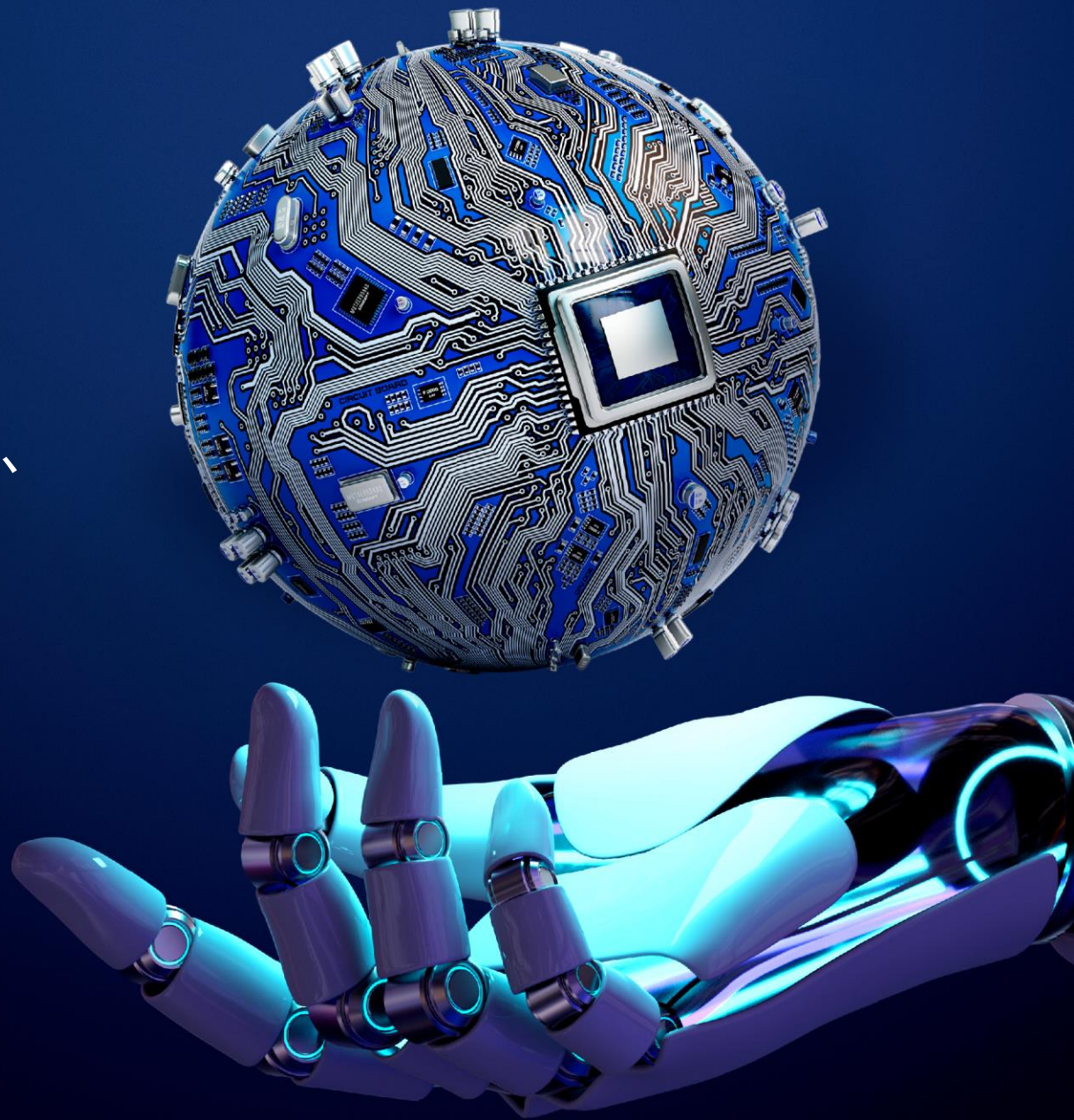
2024 年 ケミ트로ニクス事業本部長

2026 年 執行役員 ケミ트로ニクス事業本部長委嘱

光学・電材のマーケティングや海外樹脂子会社の社長を経て、
2024年1月に新設されたケミ트로ニクス事業本部長に就任

DICは、化学の力で、
エレクトロニクスの進化を支えてきた
そして今、先端の材料とソリューションで、
AI融合社会の実現に貢献していく

“半導体の進化を、
見えない化学で支える。DIC”



2025年度実績数値

提供価値

パッケージング & グラフィック

売上高比率	売上高	営業利益	営業利益率
	5,497億円	311億円	5.7%

包装材料を通じて社会や暮らしに「安全・安心」を提供する

カラー & ディスプレイ

売上高比率	売上高	営業利益	営業利益率
	2,464億円	50億円	2.0%

表示材料を通じて社会や暮らしに「彩り」を提供する

ファンクショナルプロダクツ

売上高比率	売上高	営業利益	営業利益率
	2,909億円	231億円	7.9%

機能材料を通じて社会や暮らしに「快適」を提供する

主要製品

パッケージ用インキ



接着剤



包装材料

←ポリスチレン
↓多層フィルム



ジェットインキ

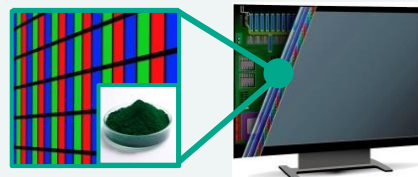


セキュリティインキ（偽造防止用途）



飲料容器の
デポジット
制度向け等

ディスプレイ用顔料



化粧品用顔料



スペシャリティ用顔料

農業用途



建材用途



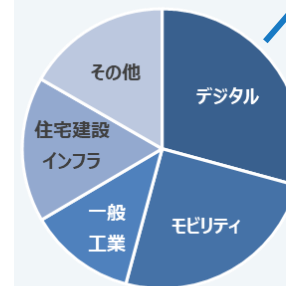
プラスチック用顔料

インキ用顔料

塗料用顔料



需要業界別売上高 構成比イメージ



◆電気・電子やディスプレイを中心とするデジタル分野◆



エポキシ樹脂

UV硬化型樹脂

工業用テープ

中空糸膜モジュール

◆モビリティ（自動車など）を中心とする工業分野◆

自動車内外装：

水性樹脂
アクリル樹脂

ウレタン樹脂
ポリエステル樹脂

自動車部品：

PPSコンパウンド

- 売上規模は全社の約7%だが、営業利益は約18%を担う見通し

ケミトロニクス売上

781億円

2025実績 653億円から+19.7%

営業利益

141億円

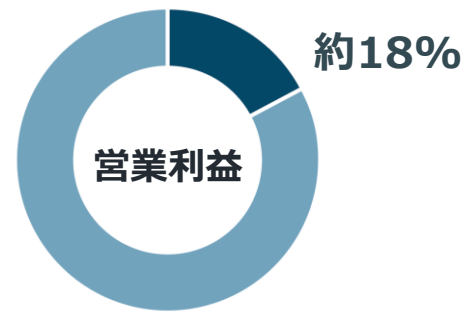
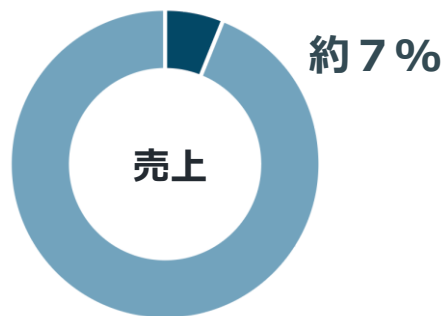
2025実績 78億円から+80.6%

営業利益率

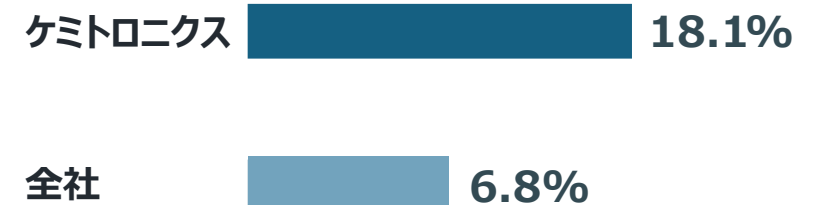
18.1%

2025実績 12.0%から改善

全社に占めるケミトロニクスの比率（2026見通し）



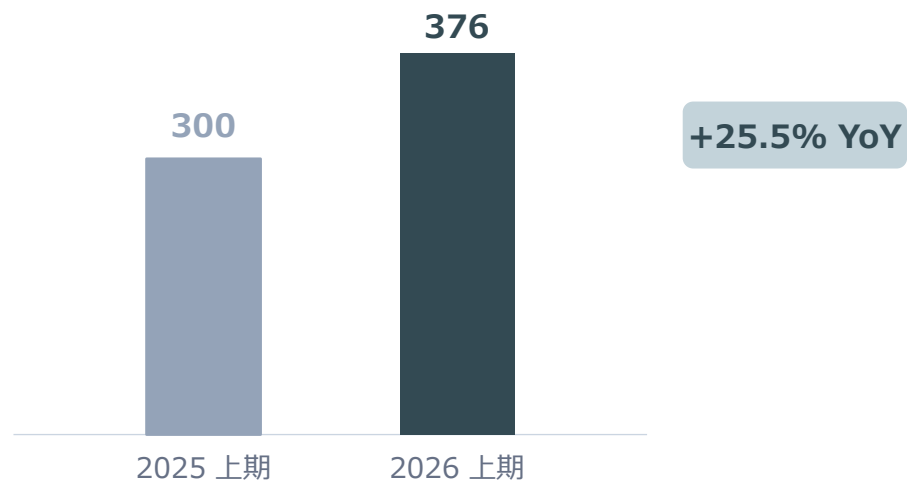
営業利益率の比較（2026見通し）



- AI向け半導体需要とモバイル端末向け採用拡大が売上・利益の両方を押し上げた

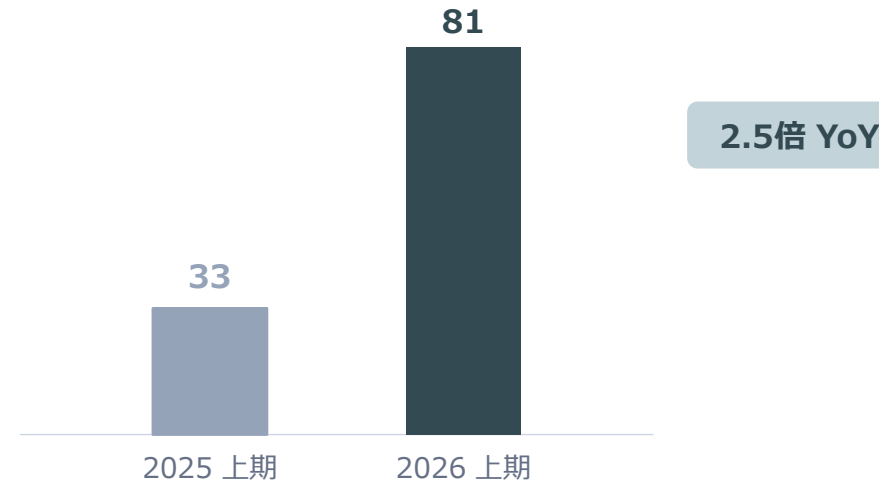
＜ケミトロニクス事業の売上高と営業利益推移＞

売上高（億円）



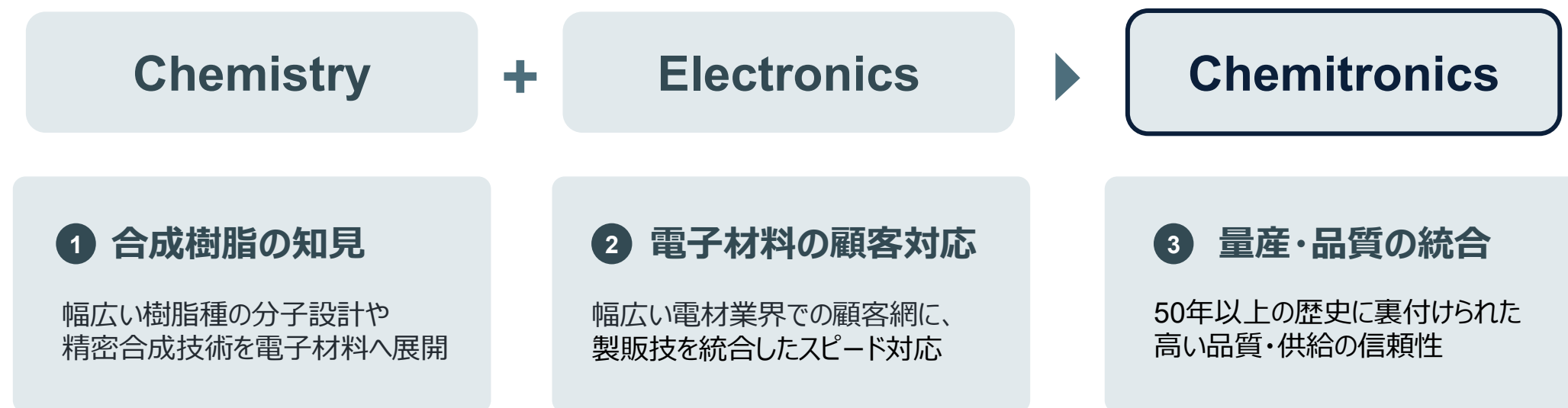
低誘電樹脂・工業テープなどが伸長

営業利益（億円）



営業利益率: 10.9% → 21.6%

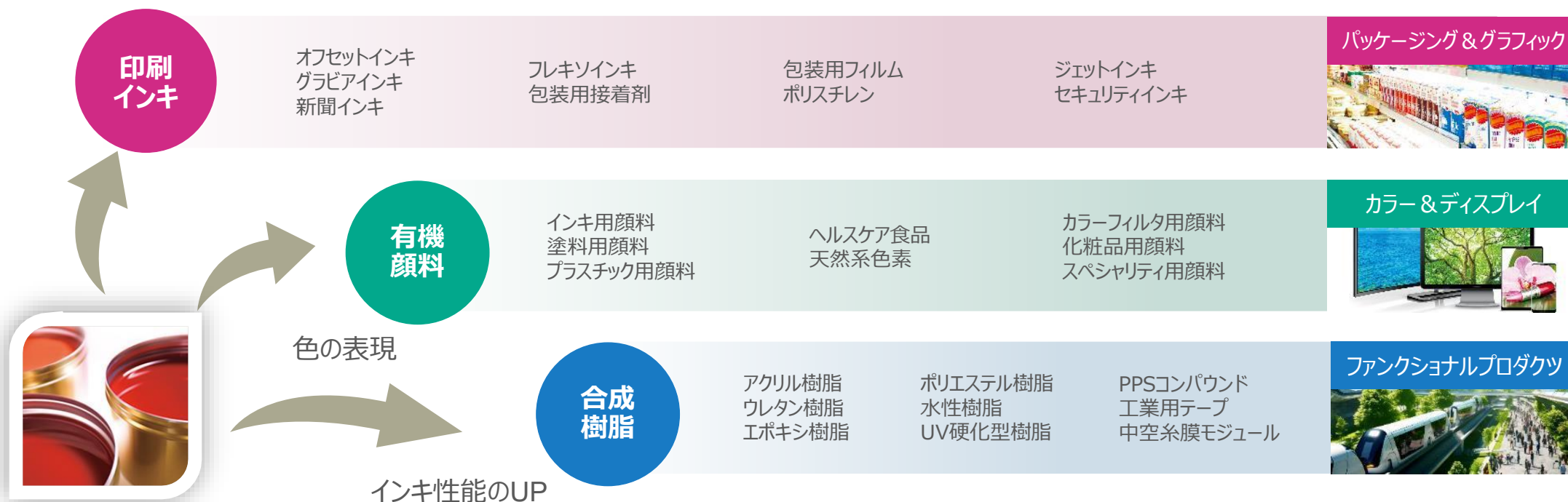
- 2024年の事業本部化で、電子材料関連の製品・技術・生産を横断的に束ねる



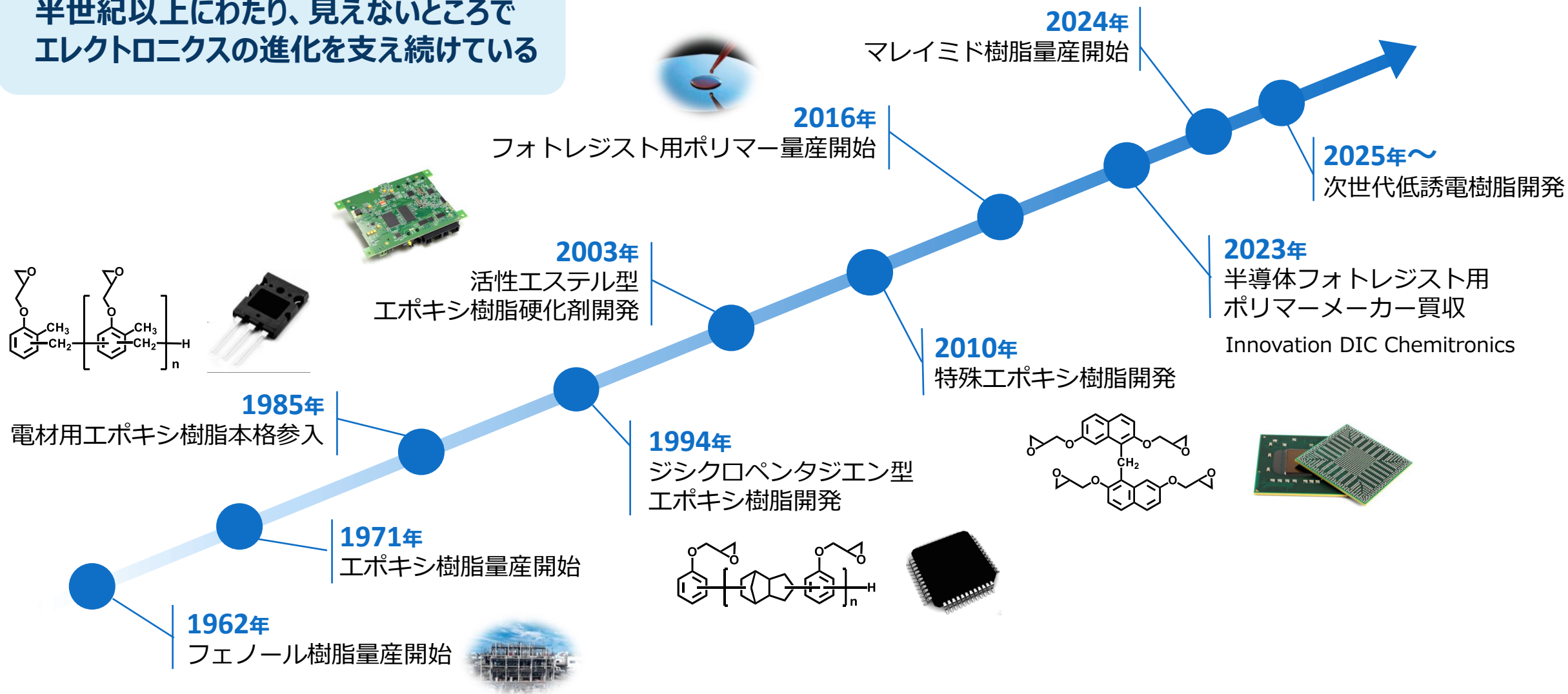
先端電子材料の顧客課題に対してDICの総力を組み合わせた事業プラットフォーム



1908	1925	1952	1962	1986	2008	2021
川村インキ製造所として創業	有機顔料の自社生産を開始	合成樹脂事業に本格参入	大日本インキ化学工業の発足	Sun Chemical社のグラフィックアーツ部門を買収	DIC株式会社に社名変更	BASF社顔料事業を買収



半世紀以上にわたり、見えないところで
エレクトロニクスの進化を支えている



《半導体》

前工程

ウエハー回路形成

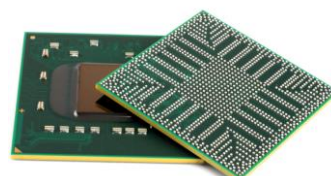


□ 半導体フォトリソ用

- ・フェノール樹脂 PHENOLITE®
- ・界面活性剤 MEGAFACE®

後工程

半導体チップのパッケージ化



□ 半導体パッケージ周辺材料

- エポキシ樹脂 EPICLON®
- ・パッケージ基板用絶縁樹脂
- ・一次アンダーフィル用絶縁樹脂
- ・半導体封止用絶縁樹脂

配線・実装工程

基板の配線・実装化

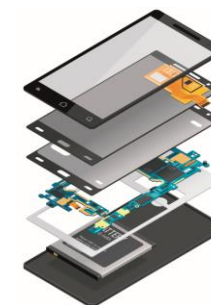


□ プリント配線板用材料

- エポキシ樹脂 EPICLON®
- ・マザーボード用絶縁樹脂
- ・ソルダーレジストインキ用樹脂
- ・二次アンダーフィル用絶縁樹脂

アッセンブリ工程

セット組立



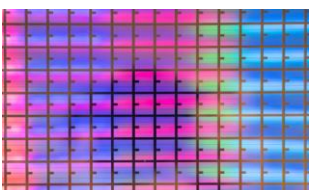
□ 接着・接合ソリューション材料

- DAITAC®シリーズ
- ・超薄型両面テープ
- ・発泡体両面テープ
- ・飛散防止テープ
- ・電磁波シールドテープ
- ・易解体テープ

《FPD》

TFTアレイ工程

画素回路形成

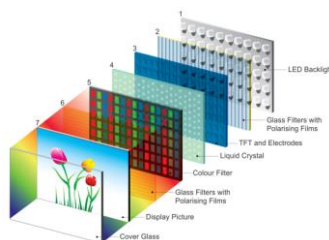


□ FPDフォトリソ用

- ・フェノール樹脂 PHENOLITE®
- ・界面活性剤 MEGAFACE®

セル・パネル工程

FPDセル組立



□ 偏光板用光学材料

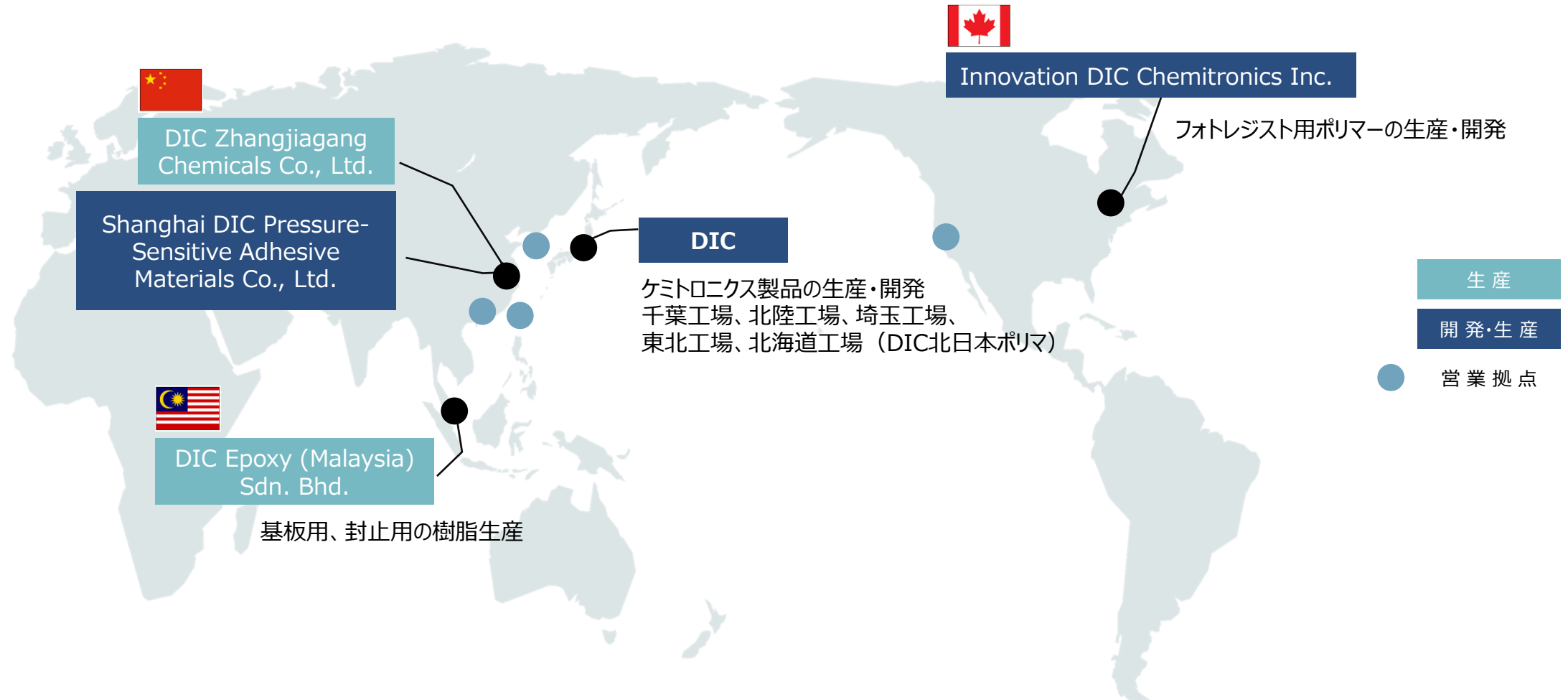
□ TP（タッチパネル）用光学材料

ハードコート用、屈折率調整用

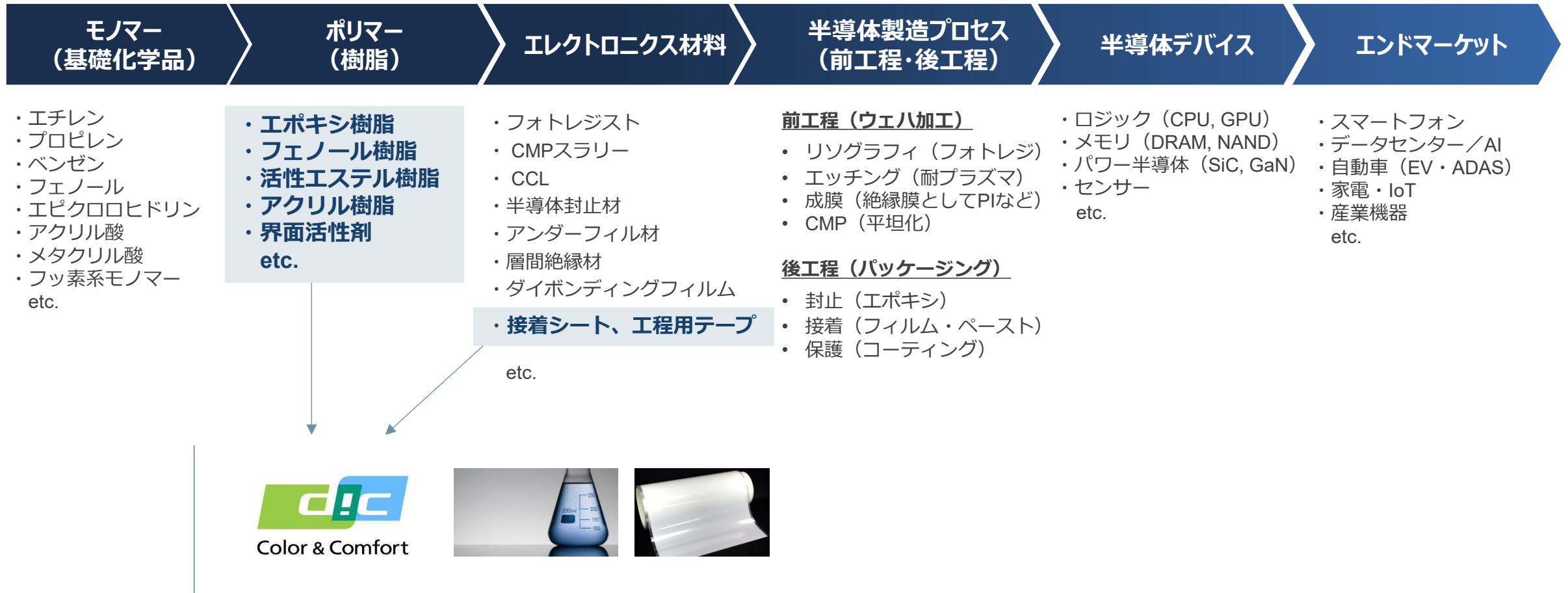
□ BLU（バックライト）用光学材料

- 紫外線硬化型樹脂/塗材
- LUXYDIR® GRANDIC®
- 界面活性剤 MEGAFACE®

日本を中心にアジア、北米で安定した供給能力と顧客密着型の開発体制を確保

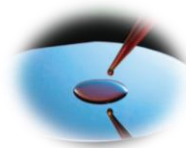
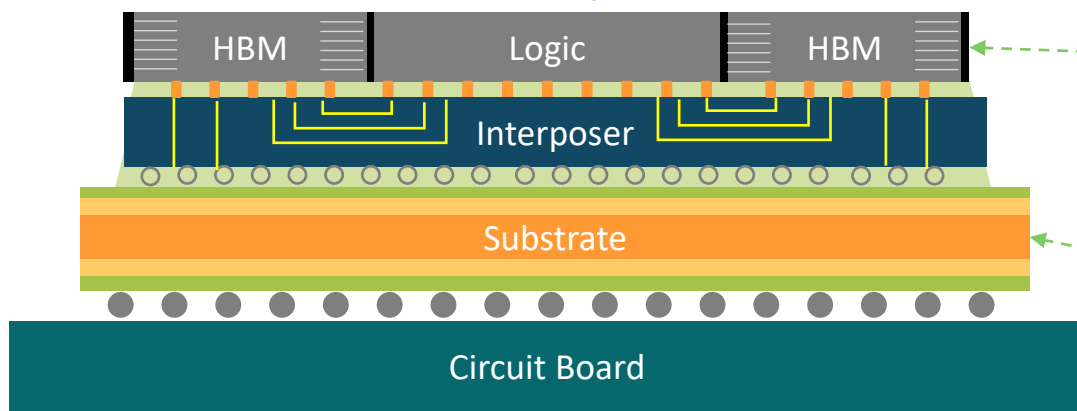


DICはエレクトロニクスの基盤を支えるポリマー素材を幅広く提供



半導体材料に求められる高度な要求特性を、陰で支えるケミ트로ニクスポリマー

AI半導体で求められる先端PKG構造



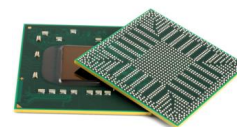
フォトリソグラフィ

半導体の微細化と歩留まりを向上



封止材

チップ保護と信頼性向上に貢献



パッケージ基板材料

高密度実装と信頼性を支える基盤

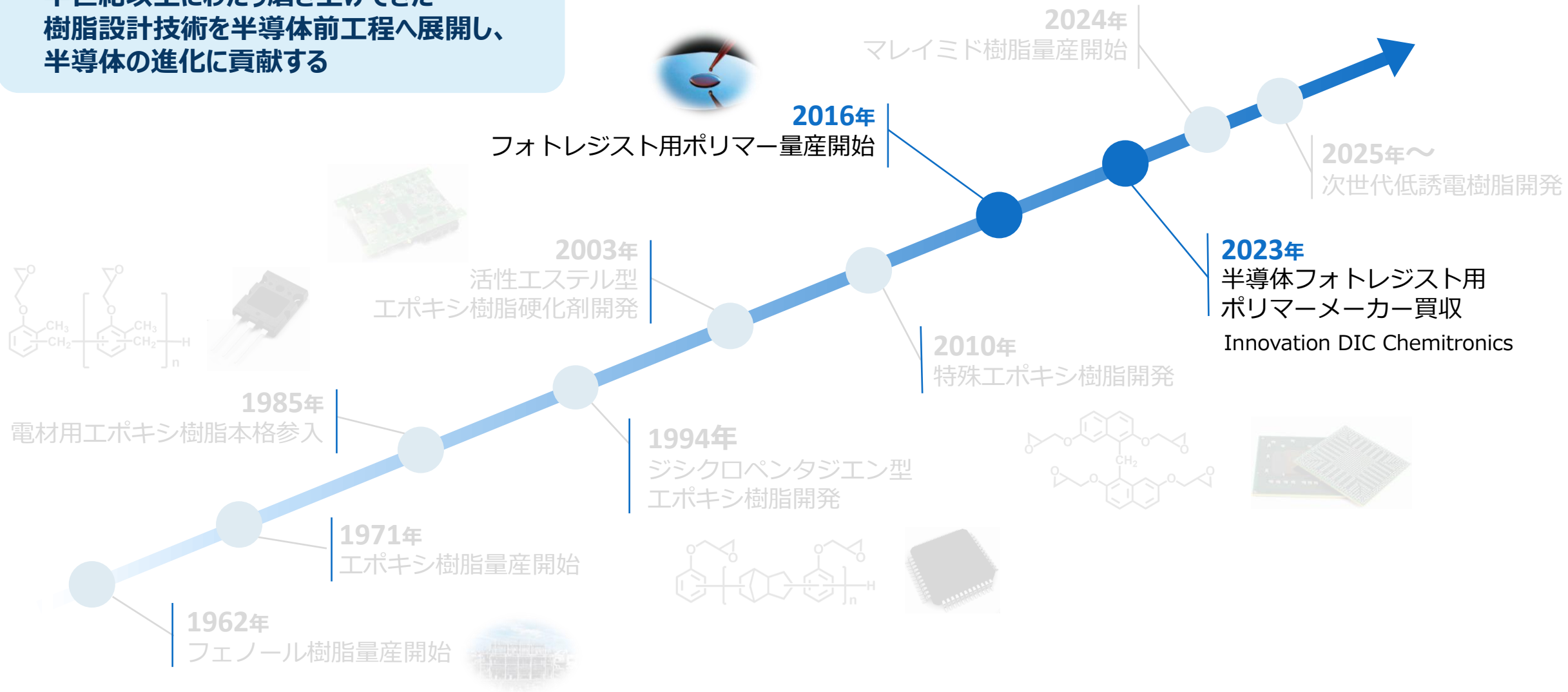


プリント基板材料

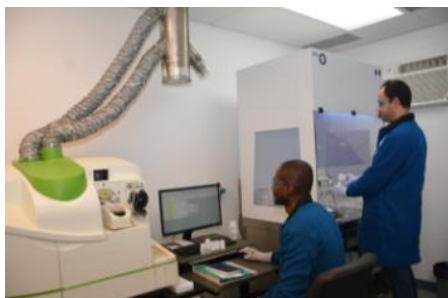
高速大容量通信を支える基板材料

前工程材料

半世紀以上にわたり磨き上げてきた
樹脂設計技術を半導体前工程へ展開し、
半導体の進化に貢献する



- IDCで1989年からフォトレジスト材料を供給してきた、歴史に裏付けられた信頼品質
- 半導体の進化に伴い厳しくなる品質管理要求に応えていく分析・管理能力
- 低金属・高純度ポリマーを設計・開発から試作・量産までスピーディに一貫サポート
- 開発当事者が直接顧客と技術ディスカッションし、課題やニーズに対応するスタイル



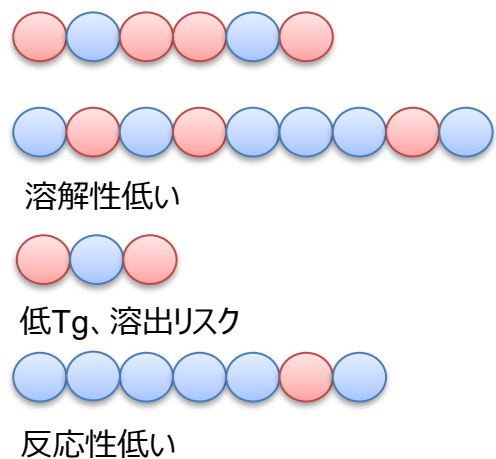
分子設計
モノマー開発

ポリマー合成
試作

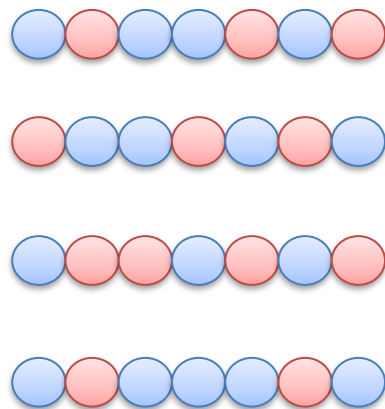
顧客評価

量産化
品質保証

従来（フリーラジカル重合）



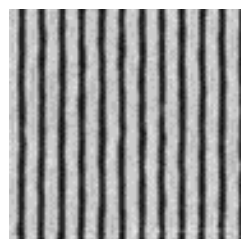
精密重合（リビングラジカル重合）



- ・ 分子量分布が狭い → 溶解性ばらつきを低減し、線幅ばらつきを低減
- ・ 高Tg化 → 酸拡散を抑制し、線幅ばらつきを低減
- ・ オリゴマー成分が少ない → 液浸水の侵入、低分子分の溶出を抑制

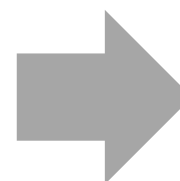
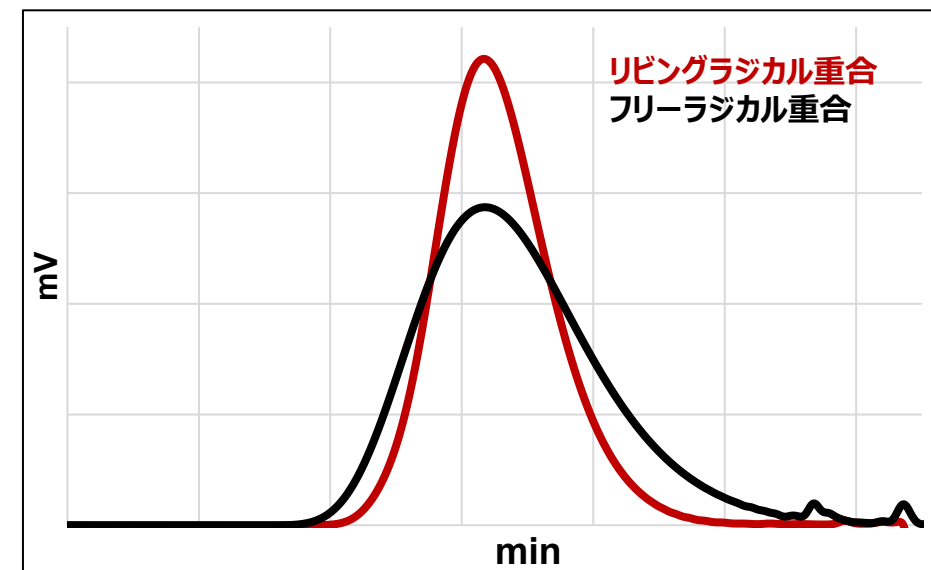


With controlled polymer



※イメージ

GPC



先端半導体に好適

- フォトレジスト材料の需要拡大に対応するため、主力工場であるカナダIDCにおいて生産能力を増強、2026年から稼働開始
- 既に顧客への供給を開始しており、今後の更なる拡大にも対応可能なレベルで増産中



IDC 新プラント外観



新プラント完成披露会

後工程材料

AI・5G/6G向け半導体デバイスの高速化に伴い、プリント配線基板には低伝送損失特性が求められている

メガトレンド



5G / 6G

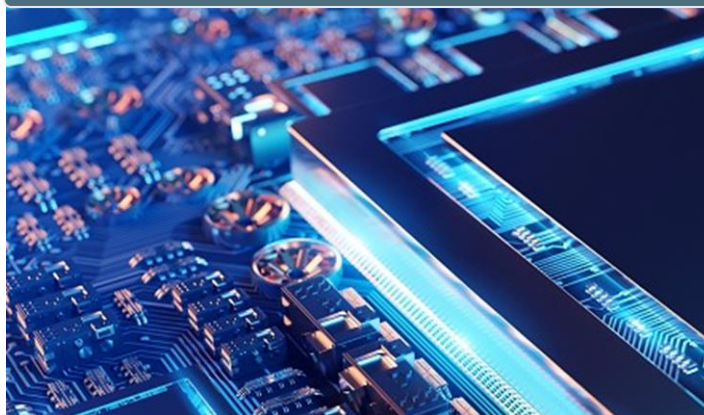


AI



自動運転

半導体デバイス



大容量・高速対応
プリント配線基板
(マザーボードやパッケージ基板)

$$\text{伝送損失} = k \times f \times \sqrt{\epsilon} \times \tan\delta$$

ϵ : 誘電率 $\tan\delta$: 誘電正接

f : 周波数 k : Factor

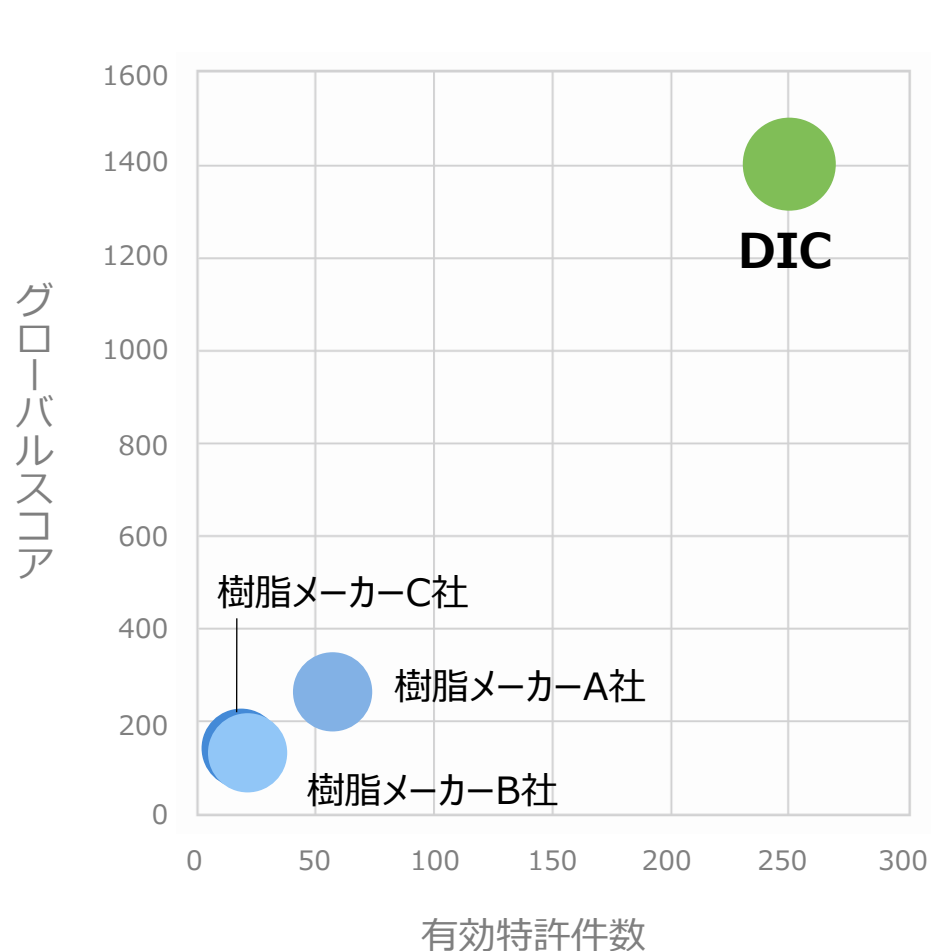
エレクトロニクス材料



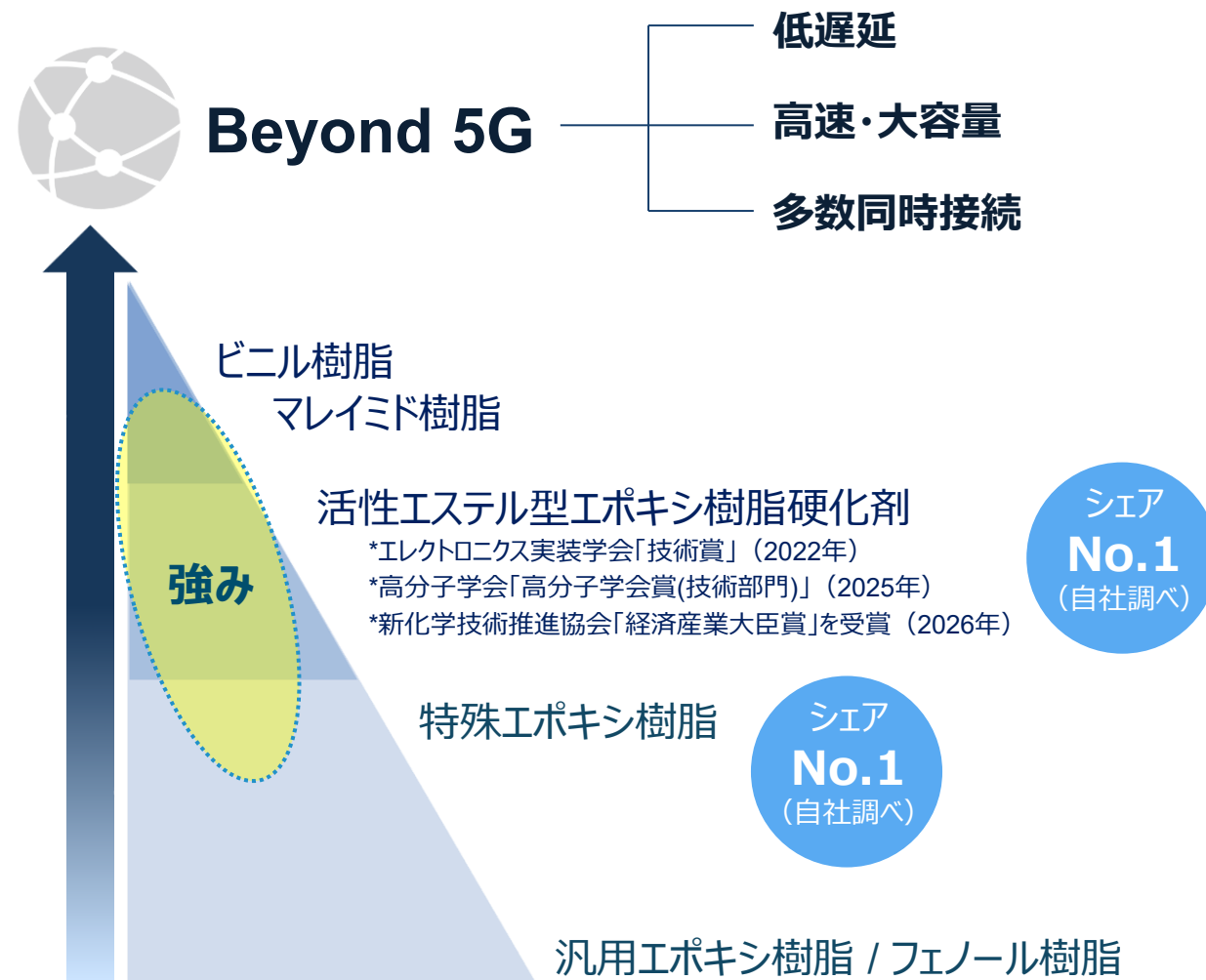
- ・銅張積層板
- ・層間絶縁材
- ・封止材
- ・アンダーフィル
- ・レジストインキ
- etc.

低誘電率 / 誘電正接

- 基板用エポキシ樹脂特許総合力世界4位。樹脂メーカーの中では圧倒的No.1のリーディングポジション
- 樹脂種に拘らない独自の分子設計により要求特性に応える



出典：株式会社パテント・リザルト社調べ



- 今後の需要拡大に向けて、電材樹脂の主力工場である千葉工場などにおいて段階的に増産体制を整備
- 半導体用エポキシ樹脂については、2025年に投資を決定。2029年からの稼働開始を目指し、着工済み
- 高品質化＋安定供給に向け、現在スケジュール通り生産能力増強に向けて進行中



千葉工場 新プラント建設予定地



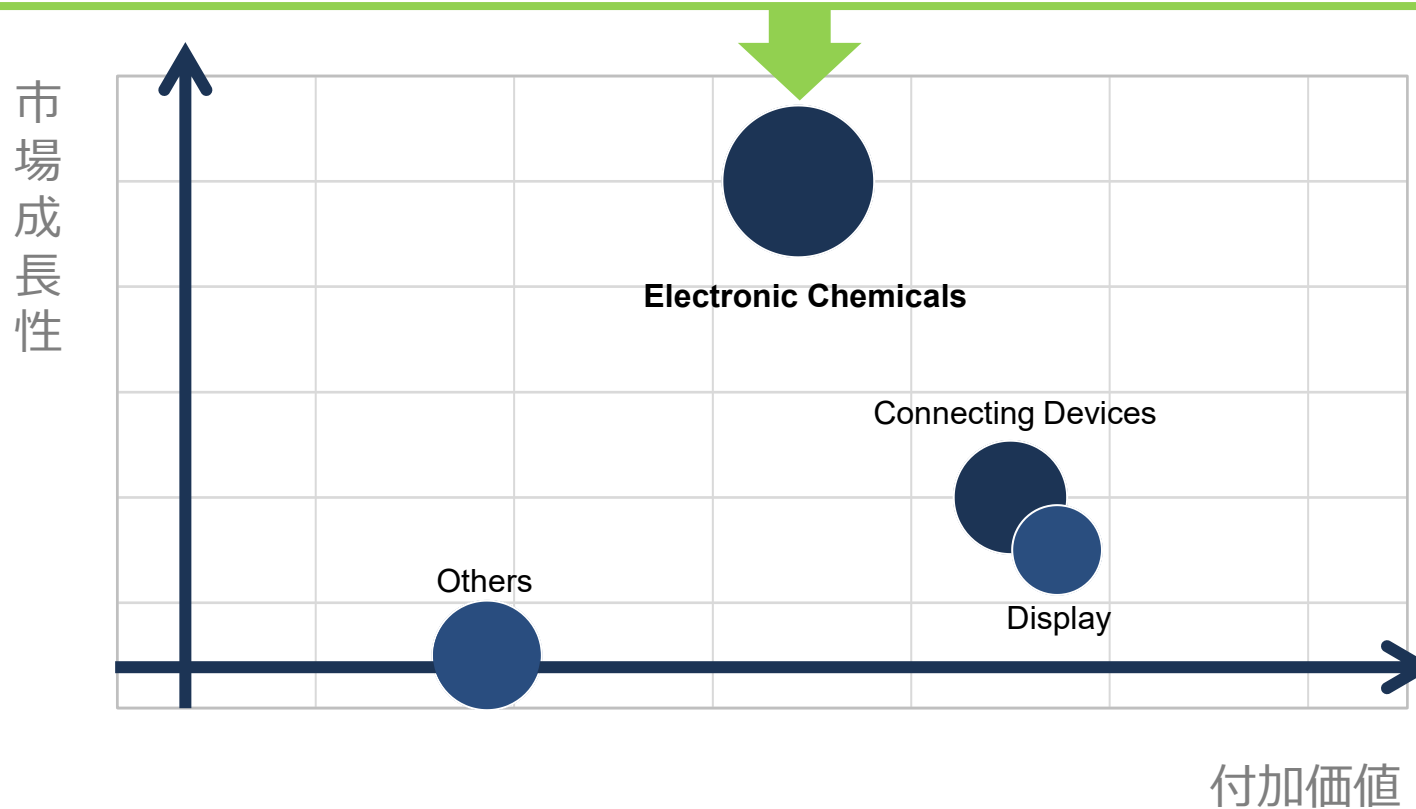
新プラント完成予想図

経済安全保障推進法に基づく「供給確保計画」に認定、対象投資額の1/3にあたる最大30億円の支援を受ける予定

まとめ

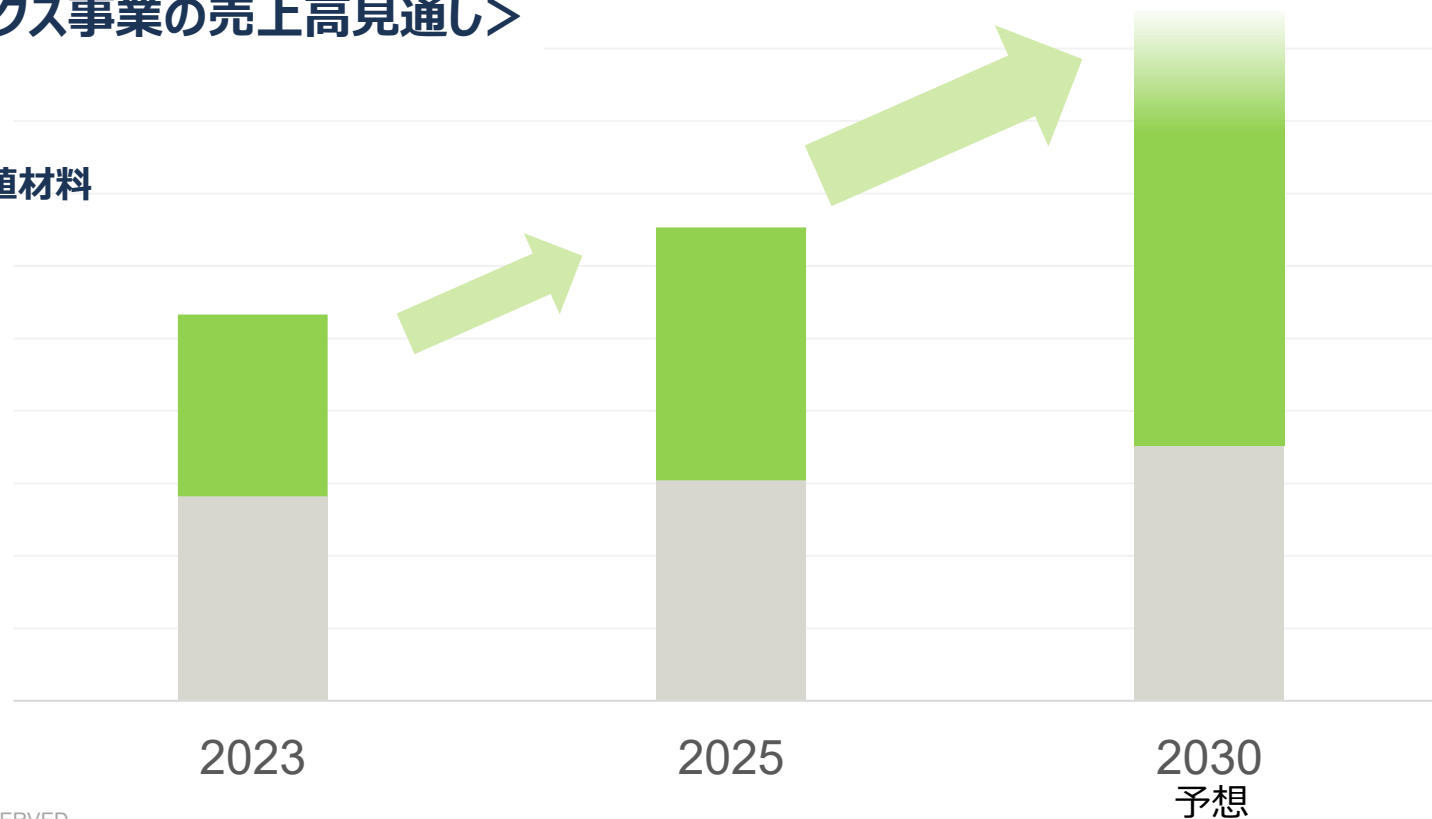
- DICは分子設計技術が強みに最先端ニーズに応え続け、トップクラスのシェアを維持
- 前工程は高品質化と新規ポリマーのニーズ、後工程には低伝送損失と高信頼性のニーズに応える開発
- 急激な成長需要を取り込むための量産基盤として**積極的な投資**を継続

マレイミド樹脂（2025年）、フォトレジスト用ポリマー（2026年）、活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤（2027年）、半導体用エポキシ樹脂（2029年）



- 市場の追い風：AI需要などにより先端半導体ニーズが高付加価値材料需要を押し上げる
- これにより、ケミトロニクス事業は、2030年に向け飛躍的な成長を見込む
- 戦略的投資を通じて、生産キャパシティを十分な水準で確保する

＜ケミトロニクス事業の売上高見通し＞



ケミトロニクス
ソリューション



- 5G/6G通信では、より高周波帯の活用が進展しており、プリント配線基板には、さらなる高信頼性、低遅延、低消費電力化が求められている
- DICは、低誘電樹脂にとどまらず、配合分散技術、精密塗工技術、無機材料技術を融合することで、AI融合社会を支える次世代低損失ソリューションの開発を推進している

有機材料設計



低誘電樹脂
EPICLON® NE-V
EPICLON® NE-X

誘電損失を低く！

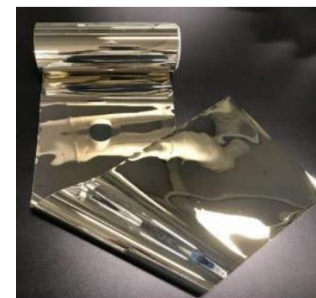
配合・加工設計



低誘電接着シート
DAITAC® BDS

無機材料設計

銀ナノ粒子導電材料
PLAZMO®



PLAZMO®塗布フィルム

導体損失を低く！

プリント配線基板

配線金属

積層板（誘電体）

低遅延

高速・大容量
多数端末接続

粗化界面→導体損失大



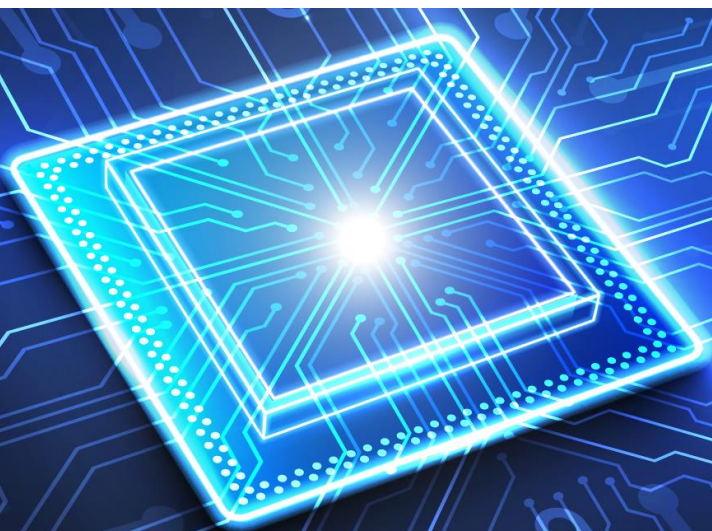
平滑化界面→導体損失小



エレクトロニクスからフォトニクスへ

これまでエレクトロニクス分野で培ってきたポリマー技術を、フォトニクス領域へと展開していきます。
DICは、低吸収損失を実現するCo-Packaged Optics (CPO) 向けポリマー光導波路材料の開発に取り組み、高速・大容量通信を支える次世代光通信の実現に貢献します。

DICの挑戦は、これからも続きます。

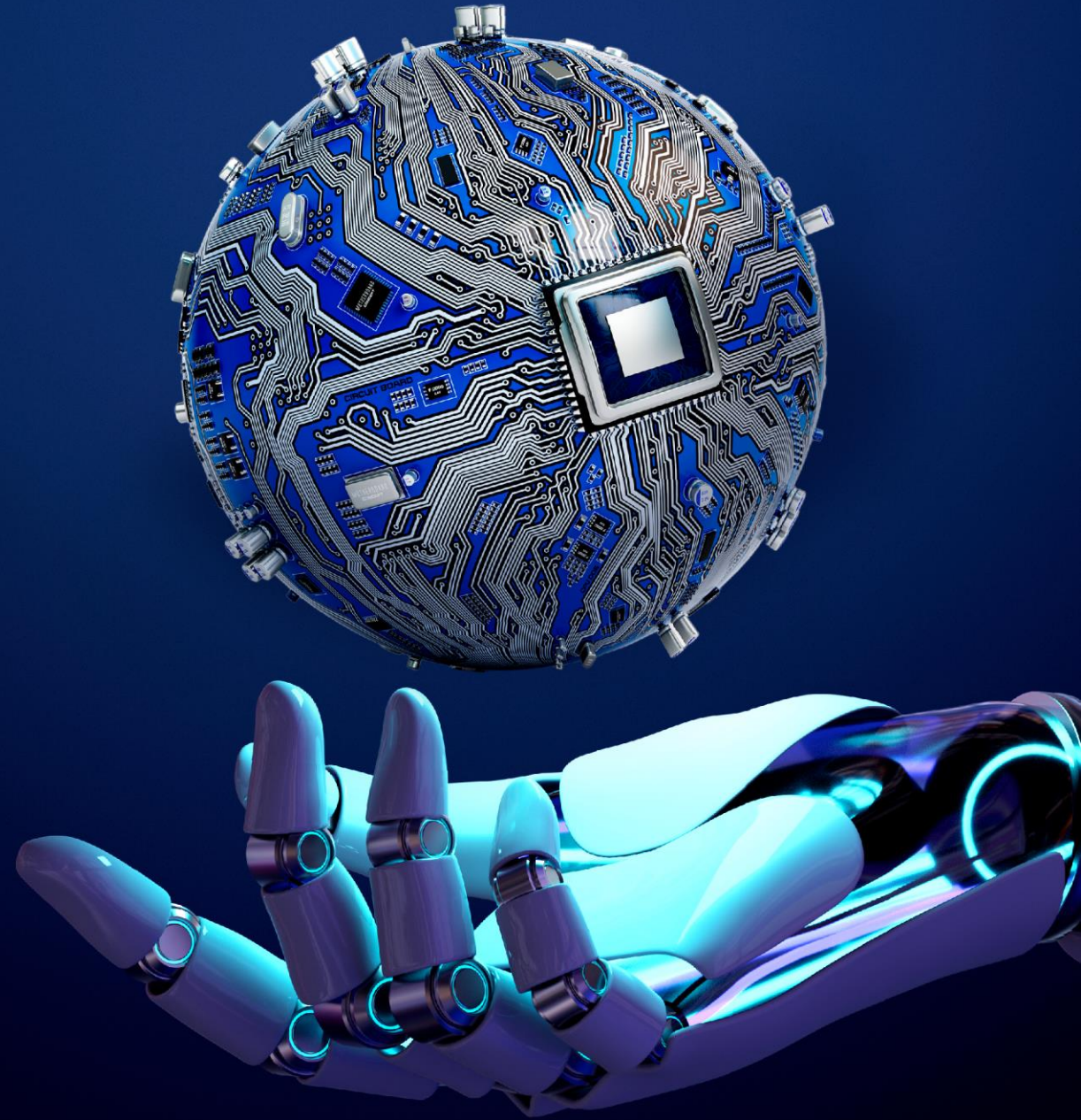


AIの進化のカギを握る
「ケミ트로ニクス材料」

“半導体の進化を、
見えない化学で支える。DIC”

化学の力でAI融合社会の実現に
挑戦するDICにご期待下さい

本日はご清聴ありがとうございました



本資料は、情報の提供を目的としており、いかなる勧誘行為を行うものではありません。

業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき、当社の経営者が判断した見通しですが、実際の売上高及び利益は、記載している予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

当社は、業績見通しの正確性・完全性に関する責任を負うものではありません。

ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いいたします。

本資料に全面的に依存して投資判断を下すことによって生じ得るいかなる損失に関しても、当社は責任を負うものではありません。